

MINIFLEX® 3-BFNH L

Part No. 20605-0**E-0#

Product Specification

Qualification Test Report No. TR-14022

4	S24207	May 30, 2024	E.Tanaka	M.Muro	T.Masunaga
3	S21666	December 28, 2021	M.Muro	-	H.Ikari
2	S19586	September 26, 2019	S.Shigekoshi	M.Muro	H.Ikari
1	S15429	September 15, 2015	M.Muro	-	E.Kawabe
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

1. 適応範囲

本規格は、コンタクトピッチ 0.3mm の基板対 FPC コネクタである MINIFLEX 3-BFNH L コネクタの性能と試験条件について規定する。

2. 製品名称及び製品型番

2.1 製品名称

MINIFLEX 3-BFNH L

2.2 製品型番

20605-0**E-0#

3. 定格

3.1 使用条件

電流 …… 0.3A DC (per contact)

電圧 …… 50V AC (per contact)

使用温度 …… 233~358K (-40℃~+85℃)
(通電による温度上昇含む)

使用湿度 …… 85% max.

3.2 保管条件

保管温度 …… Connector : 233~358K (-40℃~+85℃)

Emboss Packing : 248~333K (-25℃~+60℃)

保管湿度 …… 85% max. (結露無きこと)

保管期間 …… 納入後 1 年以内 (弊社梱包状態)

3.3 適合導体厚

t=0.20±0.03 (FPC)

熱硬化性接着剤仕様

4. 試験及び性能

4.1 試験条件

全ての測定と試験は、MIL-STD-202G に基づき以下の条件で行う。

温度 …… 288K~308K (15℃~35℃)

気圧 …… 866hPa~1066hPa (650mmHg~800mmHg)

相対湿度 …… 45~75%R.H.

4.2 試験及び性能

4.2.1 電気的性能

(1) 接触抵抗

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、開回路電圧 20mV DC 以下、短絡電流 1mA DC 以下で 4 端子法にて Fig.2 に示す区間の接触抵抗を測定する。MIL-STD-202G 試験法 307 に準拠。
テスト基板、及び FPC の導体抵抗は除く。

B.必要条件 …… 接触抵抗の値は、表 1 の値を満足すること。

表 1 接触抵抗

初期値	60mΩ MAX.
試験後	ΔR= 40mΩ MAX.

(2) 耐電圧

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、隣接する端子間に AC 250V(実効値)を一分間印加する。MIL-STD-202G 試験法 301 に準拠。

B.必要条件 …… 沿面放電、空中放電、絶縁破壊等の異常のないこと。

(3) 絶縁抵抗

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、隣接する端子間に DC 250V を印加し測定する。MIL-STD-202G 試験法 302 に準拠。

B.必要条件 …… 100MΩ以上のこと。

(4) 温度上昇

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、各コンタクトに定格電流を通電させ、コネクタ周囲温度上昇を測定する。

B.必要条件…… 温度上昇ΔT : 30K(30℃)MAX.

4.2.2 機械的性能

(1) アクチュエータ操作力

- A.試験法 …… テスト基板にコネクタを半田付け後、FPC をコネクタに挿入し、アクチュエータをロック及び解除させる。
- B.必要条件 …… 試験前後のアクチュエータ操作力は、表 2 の値を満足すること。

表 2 アクチュエータ操作力

n: 芯数	アクチュエータロック力	アクチュエータ解除力
初期値	0.245 N (24.5gf) ×n MAX.	0.014N (1.4gf) ×n MIN.
20 回目	0.245 N (24.5gf) ×n MAX.	0.014N (1.4gf) ×n MIN.

※ n は極数

(2) FPC 保持力

- A.試験法 …… 適合する導体を嵌合したコネクタを挿抜試験機に取り付け、適合する導体を嵌合軸に平行に毎分 25±3mm の速度で、抜去を行う。
- B.必要条件 …… FPC 保持力は、表 3 の値を満足すること。

表 3 FPC 保持力

n: 芯数	FPC 保持力
初期	0.13 N (13gf) ×n MIN.
試験後	0.10 N (10gf) ×n MIN.

※ n は極数

(3) 耐久性

- A.試験法 …… テスト基板にコネクタを半田付け後、FPC を挿入しアクチュエータを 20 回繰り返し操作する。
- B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は表 1 を、アクチュエータ操作力は表 2 を、FPC 保持力は表 3 を満足すること。

(4) 端子保持力

- A.試験法 …… コネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 25±3mm の速度で端子に圧入と逆方向の荷重を加え、端子がコネクタより抜ける時の荷重を測定する。
- B.必要条件 …… 端子保持力は、0.3N (30.6gf) 以上のこと。

(5) 振動

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、振動試験機に取り付け、以下の振動を加える。試験中 1mA DC の電流を流して電氣的瞬断の有無を確認する。
MIL-STD-202G 試験法 201A に準拠。

周波数 …… 10Hz→55Hz→10Hz/約 1 分

方向 …… 3 つの互いに直角な方向

全振幅 …… 1.52mm

掃引時間 …… 各方向に 2 時間、計 6 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は表 1 の値を満足し、試験中、1 マイクロ秒を超える電氣的瞬断のないこと。
外観は機能を損なう異常無き事。

(6) 衝撃

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、衝撃試験機に取り付け、以下の衝撃を加える。
試験中 1mA DC の電流を流して電氣的瞬断の有無を確認する。
MIN-STD-202G 試験法 213B 試験条件 A に準拠。

最大加速度 …… 50 G

標準持続時間 …… 11msec.

波形 …… 半波正弦波

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は表 1 の値を満足し、試験中、1 マイクロ秒を超える電氣的瞬断のないこと。
外観は機能を損なう異常無き事。

(7) 微加振

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、微加振試験機に取り付け、以下の衝撃を与え、試験中 1mA DC の電流を流して電氣的瞬断の有無を確認する。

最大加速度 …… 100 G

加振回数 …… 20,000 cycles (50~60Cycles/min.)

B.必要条件…… 試験前後の接触抵抗は表 1 の値を満足し、試験中、1 マイクロ秒を超える電氣的瞬断のないこと。
外観は機能を損なう異常無き事。

4.2.3 耐環境性

(1) 熱衝撃

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。

温度 …… 233K(-40°C):30 min. → 358K (+85°C):30 min.

回数 …… 200 サイクル

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は、表 1 の値を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

(2) 高温放置

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。

MIL-STD-202G 試験法 108A 試験条件 D に準拠。

温度 …… 358±2 K (85±2°C)

期間 …… 1000 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は、表 1 の値を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

(3) 高温高湿通電

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件において定格電圧を連続印加する。

温度 …… 333 K (60°C)

湿度 …… 90%RH

期間 …… 1000 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は表 1 の値を満足し、耐電圧は 4.2.1.(2)を、絶縁抵抗は、4.2.1.(3)を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

(4) 高温高湿放置

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。

温度 …… 333 K (60°C)

湿度 …… 90%RH

期間 …… 1000 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は表 1 の値を満足し、耐電圧は 4.2.1.(2)を、絶縁抵抗は、4.2.1.(3)を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

(5) 低温放置

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。

温度 …… 233 K (-40℃)

期間 …… 1000 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は、表 1 の値を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

(6) ガス : H₂S

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。

試験槽温度 …… 317 K (40℃)

ガス …… H₂S 3ppm

湿度 …… 80%RH

期間 …… 96 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は、表 1 の値を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

(7) ガス : SO₂

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。

試験槽温度 …… 317 K (40℃)

ガス …… SO₂ 25ppm

湿度 …… 80%RH

期間 …… 96 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は、表 1 の値を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

(8) 塩水噴霧

A.試験法 …… コネクタをテスト基板に半田付け後、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。

MIL-STD-202G 試験法 101E 試験条件 B に準拠。

温度 …… 308±2 K (35±2℃)

塩水濃度 …… 5±1% [重量比]

期間 …… 48 時間

B.必要条件 …… 試験前後の接触抵抗は、表 1 の値を満足すること。

外観は機能を損なう異常無き事。

4.2.4 その他

(1) 半田濡れ性

A.試験法 …… 以下の環境条件で前処理を行ったコネクタの、端子の半田付け部を $528 \pm 2 \text{ K}$ ($255 \pm 2^\circ\text{C}$)の半田槽内に浸す。EIAJ-ET7404（急加熱法）に準拠する。

前処理条件：PCT

温度 …… 378K (105°C)

湿度 …… 100%RH

期間 …… 4 時間

B.必要条件 …… ゼロクロス時間 3 秒以内。又、浸した面積の 95%以上に半田がむらなく付着すること。

(2) 半田耐熱性

A. 試験法 ……

< リフロー >

① リフロー部

533K (260°C) ピーク

503K (230°C)MIN. 30~40 秒

② 予熱部

$423 \sim 453\text{K}$ ($150 \sim 180^\circ\text{C}$) 60~120 秒

リフロー回数は 2 回以内

前処理条件：PCT

温度 …… 358K (85°C)

湿度 …… 85%RH

期間 …… 24 時間

< 手半田 >

こて先温度 …… $663 \pm 10\text{K}$ ($390 \pm 10^\circ\text{C}$)

加熱時間 …… 3.0 ± 0.5 秒

加熱回数 …… 2 回

B.必要条件 …… 機能を損なう変形及び欠陥の無い事。

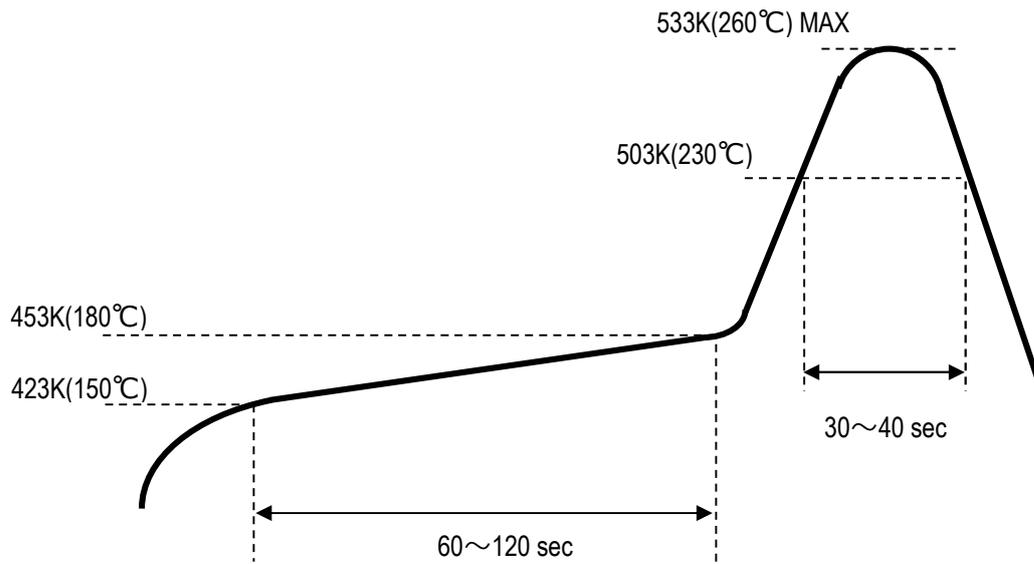


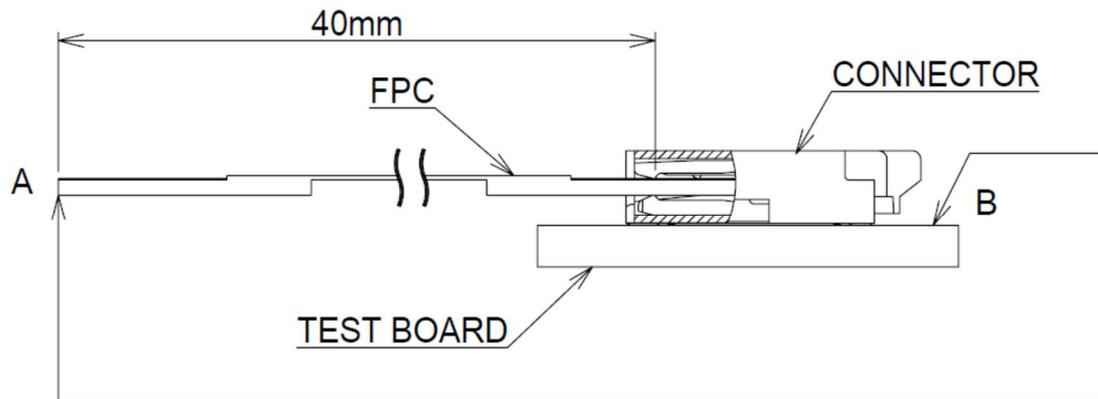
Fig. 1 リフロープロファイル

4.2.5 試験順序と試料数

表 4 試験順序と試料数

試験項目	グループ															
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
接触抵抗	2,7			1,3, 5	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3			
耐電圧								2,6	2,6							
絶縁抵抗								3,7	3,7							
温度上昇																1
アクチュエータロック力	1,5															
アクチュエータ解除力	3,6															
FPC 保持力		1,3														
耐久性	4	2														
端子保持力			1													
振動				2												
衝撃				4												
微加振試験					2											
熱衝撃						2										
高温放置							2									
高温高湿通電								2								
高温高湿放置									2							
低温放置										2						
ガス (H ₂ S)											2					
ガス (SO ₂)												2				
塩水噴霧													2			
半田付け性														1		
半田耐熱性															1	
試料数	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs

グループ表中の番号は、試験順序を示す。



$$\text{接触抵抗} = R_{AB} - \text{FPC40mm 分} - \text{Test Board 分の抵抗}$$

Fig. 2 接触抵抗

5. 推奨メタルマスク

推奨マスク厚と開口寸法に関しては、図面参照願います。

6. コネクタ取り扱いの注意

本コネクタの取り扱いに関しては、取り扱い説明書：HIM-14004 を参照願います。